

5-2267254-8 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 50/50 栅格

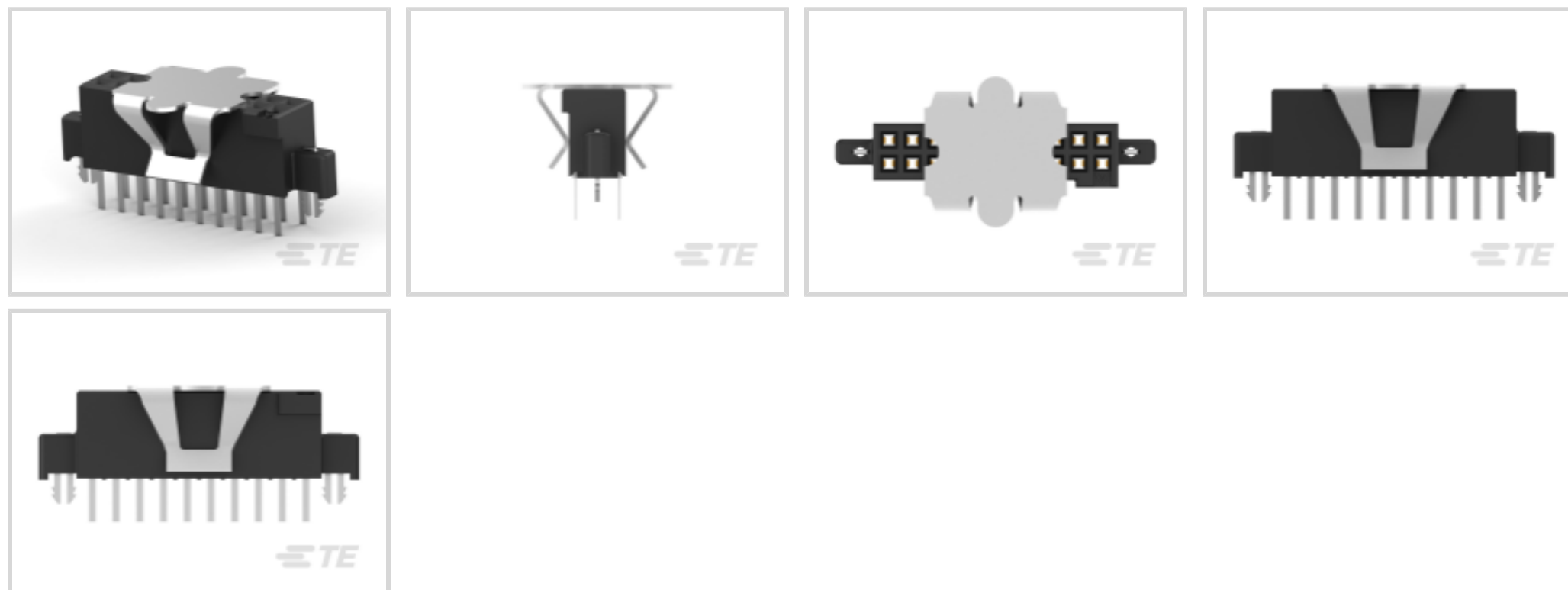
TE 内部编号 5-2267254-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 80 Position, 1.27 mm [.05 in] Centerline, Gold (Au), Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU 50/50 Grid

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 80

行数: 2

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

装载位置数量	80
PCB 安装方向	垂直
位数	80
行数	2

电气特征

端接电阻	12 mΩ, 14 mΩ, 16 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ
接触电阻	12 mΩ, 14 mΩ, 16 mΩ



介质耐压（最大值） 300 VAC

主体特性

装配过程特性材料 铝合金
主要产品颜色 黑色

接触件特性

端子底板材料 镍
接合插针直径 .46 mm[.018 in]
端子接合区域电镀材料厚度 .76 μm[30 μin]
端子基材 铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料 锡
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 哑光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 3.81 μm[150 μin]
端子形状和构造 双, 矩形
端子布局 直插式
端子接触部电镀材料 金 (Au)
端子类型 母端
端子额定电流（最大值） .5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度 .35 mm[.014 in]
矩形端接柱体和尾部厚度 .1 mm[.004 in]
端接柱体和尾部长 2.23 mm[.088 in]
PCB 端接方法 通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型 极化公端
PCB 安装固定类型 压紧
PCB 安装对准类型 压紧
PCB 安装固定 带有
PCB 安装对准 带有
连接器安装类型 板安装
接合对准 带有

壳体特性

接合入口位置 顶部



外壳材料	LCP
------	-----

中心线 (间距)	1.27 mm [.05 in]
----------	------------------

尺寸

行间距	1.27 mm [.05 in]
-----	------------------

堆叠高度	6.35 mm, 8.12 mm, 9.9 mm [.25 in][.32 in][.39 in]
------	---

连接器宽度	3.05 mm [.12 in]
-------	------------------

连接器高度	4.75 mm [.19 in]
-------	------------------

连接器长度	51.2 mm [2.02 in]
-------	-------------------

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm [.062 in]
-------------	-------------------

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---

工组温度范围	-65 – 105 °C [-85 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	真空盖
--------	-----

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
-------------	-----------------------

包装特性

封装数量	900
------	-----

封装方法	Tube
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247) SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月 (247) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---



卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

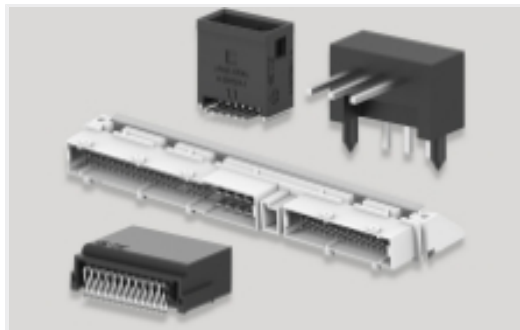
焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPMODU 50/50 栅格



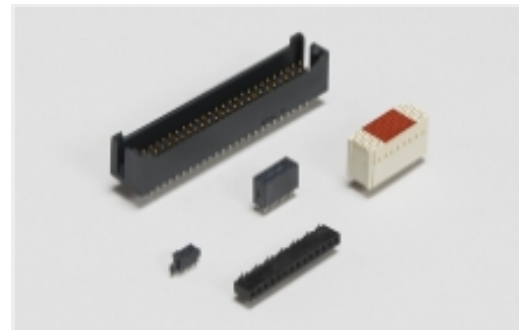
PCB 板端连接器及母端(193)



带状电缆连接器(21)



插入和拔出工具(1)



板对板接头和插座(193)



矩形电源连接器(12)



连接器盖帽(7)

客户还购买了



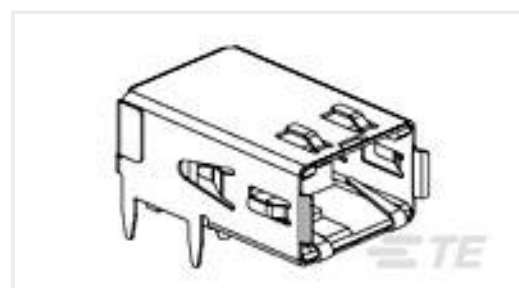
TE 产品编号5-103911-3
60 SYSTEM 50 RCPT ASSY DRRA



TE 产品编号5-104076-2
60 SYS50 HDR DRST SHRD W/SL SN



TE 产品编号3-1415020-1
PT570N20



TE 产品编号1761072-3
RECPT,HSSDC2,FIBRE,TRAY PKG



文档

产品图纸

[80 50/50 GRID DRST TH RCPT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2267254-8_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2267254-8_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-2267254-8_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU 50/50 GRID THRU-HOLE](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

5-2267254-8

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 80 Position, 1.27 mm [.05 in]
Centerline, Gold (Au), Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU 50/50 Grid



英文版本